

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 21 日(21.03.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/039029 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 73/10 (2006.01) *C09J 179/08* (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01) *C09J 183/08* (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) *C09J 183/10* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/073025
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 10 日(10.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-197953 2011 年 9 月 12 日(12.09.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡邊拓生 (WATANABE, Takuo). 李忠善 (LEE, ChungSeon).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

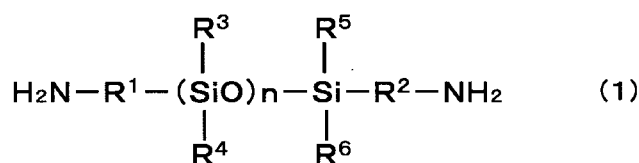
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLYIMIDE RESIN, RESIN COMPOSITION AND LAMINATED FILM THAT USE SAME

(54) 発明の名称: ポリイミド樹脂、これを用いた樹脂組成物および積層フィルム



(57) Abstract: Provided are: a polyimide film in which volatile matter is not generated due to decomposition etc., and which has good adhesiveness, even at high temperatures of 250°C and above; and a resin composition and a laminated film that use the polyimide film. The polyimide resin is characterized by having at least an acid dianhydride residue and a diamine residue, and a glass transition temperature of not more than 30°C, and is further characterized in that the diamine residue contains a polysiloxane diamine residue represented by general formula (1). (n is a natural number, and has an average value, which is calculated from the average molecular weight of the polysiloxane diamine, of five to thirty. R¹ and R² may be the same or different, and each represents an alkylene group or a phenylene group with one to thirty carbons. R³ to R⁶ may be the same or different, and each represents an alkyl group, a phenyl group or a phenoxy group with one to thirty carbons.)

(57) 要約: 250°C以上の高温でも分解等による揮発分の発生が無く、良好な粘着性を有するポリイミド樹脂、これを用いた樹脂組成物および積層フィルムを提供すること。少なくとも酸二無水物残基とジアミン残基を有し、ガラス転移温度が30°C以下であり、ジアミン残基として、一般式(1)で表されるポリシロキサン系ジアミンの残基を含むことを特徴とするポリイミド樹脂。(nは自然数であって、ポリシロキサン系ジアミンの平均分子量から算出される平均値が5~30の範囲である。R¹およびR²は、それぞれ同じでも異なってもよく、炭素数1~30のアルキレン基またはフェニレン基を示す。R³~R⁶は、それぞれ同じでも異なってもよく、炭素数1~30のアルキル基、フェニル基またはフェノキシ基を示す。)

WO 2013/039029 A1